

SAP/mSAP用途 ALPHO® NIT8300シリーズ

For SAP/mSAP process ALPHO® NIT8300 series (under R&D)

For
Projection

特長 Features

- i線プロジェクション露光に対応したSAP/mSAP用高解像密着のドライフィルムフォトレジストです。
For SAP/mSAP high resolution/adhesion Dry Film Photoresist which is suitable for patterning with i-line Projection exposure machine.
- パッケージ基板を使用する工程で求められる、低露光量で高解像密着性を得られるドライフィルム・フォトレジストです。
Achieved excellent high resolution/adhesion property with low exposure energy required in package substrate process.

レジスト特性 Resist Performance

Dry film	NIT8315	NIT8319
レジスト厚 Resist Thickness (μm)	15	19
最少現像時間*1 Minimum Developing Time (sec.)	14	18
露光量*2 Exposure Energy (mJ/cm ²)	130	130
解像密着性 Resolution and Adhesion L/S=x/x (μm)	4	4
細線密着性 Fine Line Adhesion L/S=x/4x (μm)	3	3.5
剥離時間*3 Stripping Time (sec.)	13	18
剥離片サイズ*3 Stripping Flake Size (μm)	<5mm	<5mm

*1 現像条件 (Developing condition) : 1.0%Na₂CO₃, 30°C, 0.15MPa, BP x 2

*2 i線プロジェクション露光装置 (i-Line Projection exposure machine)

*3 剥離条件 (Stripping condition) : 50°C, Amine type, Dipping test/spray test, Test piece size: 50 mm × 66 mm

層間絶縁樹脂基板上のレジスト形状 Resist Pattern on smooth substrate (Ra=50nm)

